

圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于 2024 年度向银行申请综合授信额度
及为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申请综合授信额度提供担保。现将相关情况公告如下：

一、本次申请综合授信额度及提供担保情况概述

为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在 2024 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 6 亿元的担保。授信种类包括但不限于流动资金贷款及项目建设中长期贷款、保函、开立信用证等授信业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开之日止。在不超出上述授信额度和担保额度的前提下，每笔授信、担保事项无需另行提请董事会审批，具体授信额度和担保额度以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保额度可以在被担保人之间进行调剂。

公司董事会授权总经理根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范

围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司财务部办理相关银行业务申请、审批等手续以及其他一切相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 江阴圣邦微电子制造有限公司

- 1、成立日期：2021年10月27日
- 2、注册地址：江阴市长山大道18号M幢2018
- 3、法定代表人：张世龙
- 4、注册资本：15,000万元整
- 5、经营范围：一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；集成电路设计；科技推广和应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 6、股权结构：为公司全资子公司，公司持有100%股权
- 7、财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 18,650.21 |
| 负债总额 | 3,143.40 |
| 净资产 | 15,506.81 |
| 营业收入 | 11,047.84 |
| 利润总额 | 397.19 |
| 净利润 | 397.19 |

- 8、江阴圣邦微电子制造有限公司不属于失信被执行人

(二) 哈尔滨圣邦微电子有限公司

- 1、成立日期：2023年06月29日
- 2、注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区

科创总部 2 号楼东区 1 楼 162 室

3、法定代表人：陈德英

4、注册资本：壹亿圆整

5、经营范围：一般项目：电子产品销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：为公司全资子公司，公司持有 100% 股权

7、财务数据（单位：万元）

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 资产总额 | 2,007.33 |
| 负债总额 | 16.63 |
| 净资产 | 1,990.70 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -10.30 |
| 净利润 | -10.30 |

8、哈尔滨圣邦微电子有限公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司本次审议的申请综合授信额度及为子公司提供担保事项尚未签订协议，上述申请授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信金额、担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力。公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意上述授信及担保事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的整体利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。监事会同意公司本次申请综合授信及为子公司担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司累计对外担保的金额为0元，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，无逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2024年4月26日